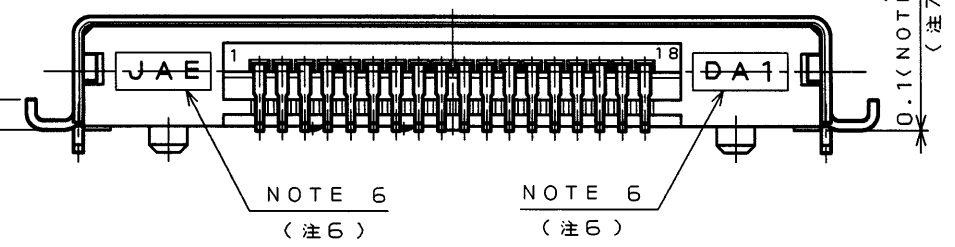
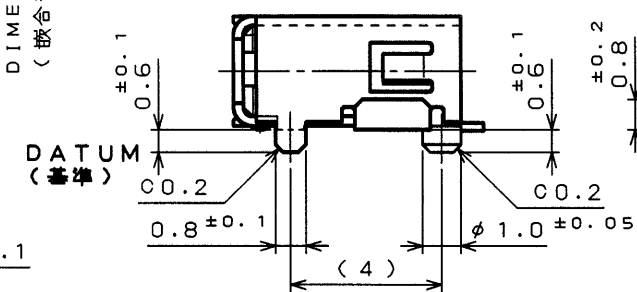
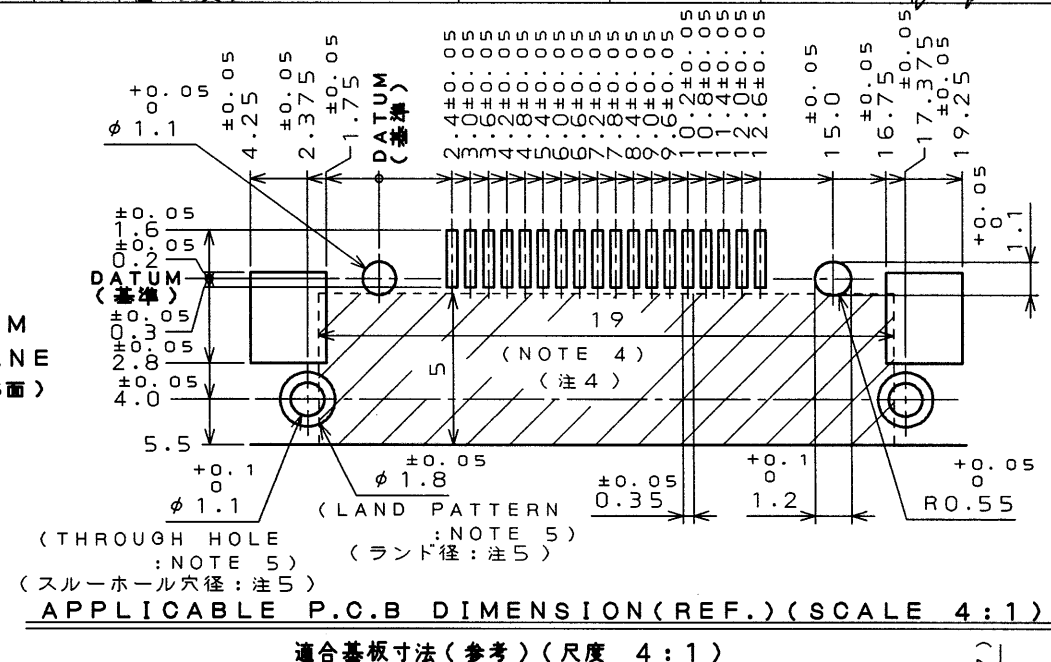
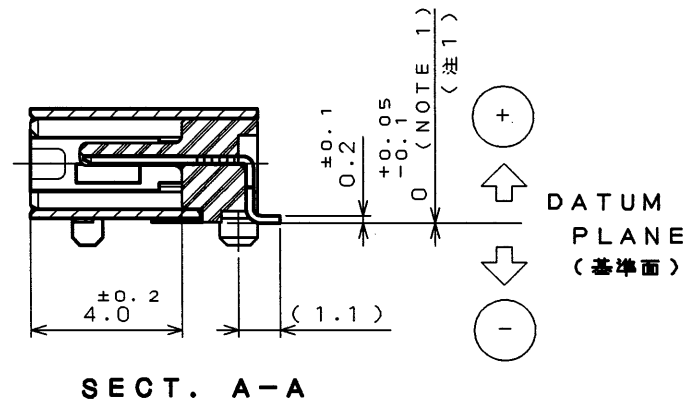
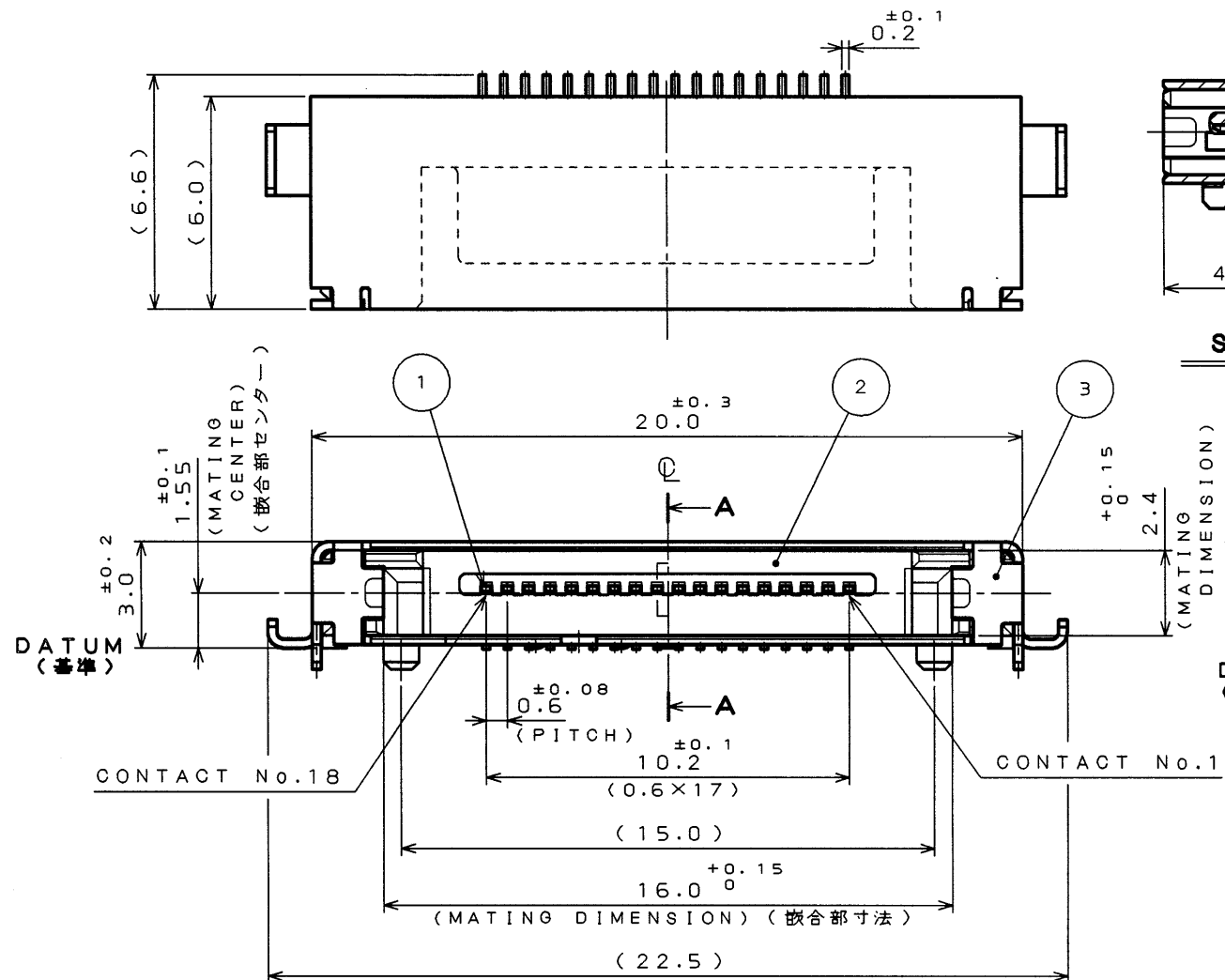


DOF-C-212D(98.02)

8507E05S
('ON 0NIMVHD)台要図図

- 注1.SMT公差部のプラス、マイナスの方向を示す。端子寸法は $0-0.1^{+0.05}$ であり公差内におけるバラツキ(1コネクタ内のMAX値とMIN値の差)は、0.1以下とする。
- △ 2.接触部は、ニッケル(1.5 μ m以上)上パラジウムニッケル(0.5 μ m以上)上金メッキ(0.05 μ m以上)結線部は、錫-鉛メッキ(1.0 μ m以上)である。
- 3.本コネクタシェル半田付部破断面には、メッキは施されません。
- 4.本斜線部内にはパターンを配線しないよう願います。
- 5.ランドは基板の両面に設けること。又、 $\phi 1.1$ の穴はスルーホールメッキであること。
- △ 6.図示の位置に社標 "JAE" 及び品名 "DA1" を表示する。
- 7.基板にのせた状態でホールドダウン部の浮きは0.1以下のこと。



- NOTE 1. ⊕ AND ⊖ DENOTE ARE DIRECTION OF SMT TOLERANCE. TERMINAL DIMENSION IS $0-0.1^{+0.05}$, AND DEVIATION (DIMENSION BETWEEN MINUS VALUE & PLUS VALUE) SHALL BE 0.1 MAX.
- △ 2. THE CONNECTING AREA IS PLATED WITH GOLD (0.05 μ m MIN) OVER Pd-Ni (0.5 μ m MIN) OVER NICKEL (1.5 μ m MIN). TERMINAL AREA IS PLATED WITH TIN-LEAD (1.0 μ m MIN).
3. THE SHEARED EDGES OF CONNECTOR SHELL AT THE SOLDER AREA ARE NOT PLATING.
4. PLEASE NO PATTERNING IN SLANT AREA.
5. LAND MARK BOTH SIDES OF P.C.B. HOLE OF $\phi 1.1$ IS THROUGH HOLE PLATED.
6. COMPANY LOGO "JAE" AND PART NUMBER "DA1" ARE MARKED AS INDICATED.
- △ 7. THE FLOATAGE OF THE HOLD DOWN AREA IN 0.1mm MAX WHILE PUT ON THE P.C.B.

3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	TIN-LEAD PLATING	
2	INSULATOR	1	PPS		UL94V-0
1	CONTACT	18	COPPER ALLOY	NOTE 2	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-3192		第1版 (ORIGINAL DATE) 26.Jun.1997		JAE-CONNECTOR.COM	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製造 DR.		名称 (TITLE) DA1R018H91	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		Y.KUBOTA	
. ±0.8		X° ±		Y.HAYASHI	
.X ±0.4		X°X' ±		承認 APPD.	
.XX ±0.1		承認 APPD.		H.SAITOU	
.XXX ±		重量 (WEIGHT)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ032058	
				版数 (REV.) 4	

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.

CSO-97-140-1151
SIZE A3